

证券代码：300260

证券简称：新莱应材

公告编号：2018-014

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

关于公司签订销售框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、协议履行存在交易对手方调整采购计划，导致供货量发生变动的风险；
- 2、协议履行存在因交付产品不符合客户标准要求，导致供货协议终止的风险；
- 3、本协议的相关内容由于涉及商业秘密，只在允许的范围内披露相关信息。

一、协议签署情况

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日与一家美资半导体设备生产公司（以下简称“某公司”）签署了年度销售框架协议。根据该协议，某公司将从公司采购高洁净不锈钢管配件和气体管路系列产品，2018年度总采购金额预计为600万美元（约4000万元人民币）。

- 1、因此次交易涉及保守商业秘密，根据相关法律法规规定，经申请，豁免披露交易对手基本情况及与交易对手发生类似交易情况。
- 2、此交易对手方与公司不存在关联关系。
- 3、交易对手方信用优良，具备良好的履约能力。

二、协议的主要内容

- 1、协议类型：年度销售框架协议
- 2、协议生效条件和时间：协议自双方授权代表签字并盖章后生效，有效期

限为一年。

3、合作方式：在协议有效期内，公司提前备货、有限安排生产排期。某公司根据度销售框架协议，分批次单独向公司下达采购订单，正式采购价格、数量、交货、财务结算等条款根据具体的采购订单为准。

其他：协议条款中已对产品质量、保密责任、协议期限及终止、知识产权、赔偿责任和争议解决等条款作出了明确的规定。

三、协议对上市公司的影响

1、本协议的履行将对公司的业绩产生积极的影响，在履行本协议过程中产生的收入将根据相应的会计准则进行收入确认，公司会按照相关披露规定，在定期报告中持续披露协议的履行情况。

2、近年来，在政策和资金的双重刺激下，中国半导体产业发展驶入快车道。根据SEMI（国际半导体产业协会）的数据，2018年中国半导体设备市场规模达113.3亿美元，同比增长49.3%，是全球增速最快的半导体设备市场，也是仅次于韩国的全球第二大半导体设备市场。据中银国际分析，中国加速投资半导体芯片制造生产线，2018—2019年有望迎来装机热潮。另据国联证券的研究报告，大基金在直接资本扶持国内半导体产业的同时，也促进了境内外资金投资国内IC产业的积极性，从而改善整个产业的融资环境。同时，在下游汽车电子、物联网、人工智能的高需求推动下，国联证券积极看好2018年半导体行业景气度。这将助推公司加速拓展包括高洁净及超高洁净管道、管件、阀门等关键部件的市场，此供货协议的签订，标志着公司全方位服务体系的进一步完善，为公司打造成为半导体核心零部件的优质供应商奠定了坚实基础。

3、公司具备履行协议的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证上述协议的顺利履行。上述协议的履行将对公司的利润产生一定积极影响。

4、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行协议而对当事人形成依赖。

四、协议风险提示

公司在本协议执行过程中在履约能力、技术、产能等方面基本不存在风险，可能会受到法规政策、行业市场、金融环境等因素的影响，敬请投资者注意防范投资风险，理性投资。

五、备查文件

公司与某公司签订的《销售框架协议》。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

二零一八年二月十二日